

クラウドを支える企業マップ

ー レイヤー別の市場規模と主要プレイヤーのシェア

レイヤー / 役割	市場規模 (円 / 年)	主要企業とシェア 黒字 = 海外 (ティッカー) / 赤字 = 日本 (証券コード)
クラウドサービス (IaaS/PaaS) 計算資源を貸すハイパースケーラー	約 80 兆円 / 年 世界計	AWS (AMZN) 約 30% ・ Azure (MSFT) 約 22% ・ Google (GOOGL) 約 13% — 3 社で約 7 割。Oracle (ORCL) 約 3% さくらインターネット (3778) ・ IIJ (3774)
OS ・ ミドルウェア ・ DB クラウド上で動く基盤ソフト ・ データ管理	約 24 兆円 / 年 DB 等	Microsoft (MSFT) ・ Oracle (ORCL) ・ AWS (AMZN) の上位 3 社で過半。クラウド特化の Snowflake (SNOW) ・ MongoDB (MDB)、監視の Datadog (DDOG) が急成長
セキュリティ 通信 ・ データ ・ ID を守る	約 40 兆円 / 年 世界計	極めて分散した市場 — 首位級の Palo Alto (PANW) ・ Fortinet (FTNT) ・ CrowdStrike (CRWD) ・ Microsoft でも各 2 ～ 4% 程度 トレンドマイクロ (4704)
半導体 (演算) AI の頭脳。GPU ・ カスタムチップ	約 32 兆円 / 年 AI 半導体のみ	NVIDIA (NVDA) 約 8 割で圧倒的首位 ・ AMD (AMD) 約 5 ～ 7% ・ カスタムチップ (Broadcom AVGO / Google ・ Amazon 自社開発) 約 1 割。製造受託は TSMC (TSM) がほぼ独占
メモリ ・ ストレージ HBM ・ DRAM ・ NAND/SSD を供給	約 49 兆円 / 年 世界計	DRAM: サムスン 38% ・ SK ハイニックス 29% ・ Micron (MU) 22% HBM: SK 約 56% ・ サムスン 21% ・ Micron 21% NAND: サムスン 29% ・ SK 18% ・ キオクシア (285A) 14%
ネットワーク ・ 光通信 DC 内外を結ぶスイッチ ・ 光配線	約 3 兆円 / 年 通信機器分	DC スイッチ : NVIDIA 約 22% ・ Arista (ANET) 約 21% ・ Cisco (CSCO) 約 2 割で拮抗 光ファイバー ・ 光部品 : フジクラ (5803) ・ 古河電工 (5801) が世界大手
DC 建設 ・ 運営 ・ 電力 / 冷却 土地 ・ 建物 ・ 電源 ・ 冷却	約 16 兆円 / 年 施設賃貸分	コロケーション首位 Equinix (EQIX) ・ Digital Realty (DLR)、 NTT (9432) が世界 3 位級 — 上位 5 社でも約 2 割と分散 電源 ・ 冷却 : Vertiv (VRT) ・ Eaton (ETN) 施工 : ダイダン (1980) ・ きんでん (1944)
半導体製造装置 最上流。チップを作る装置	約 21 兆円 / 年 世界計	ASML (ASML) 露光装置ほぼ独占 ・ Applied Materials (AMAT) ・ Lam (LRCX) ・ 東京エレクトロン (8035) — 上位 5 社で約 6 割 後工程 : アドバンテスト (6857) テスタ首位 ・ ディスコ (6146) 研削ほぼ独占

市場規模 ・ シェアは 2025 ～ 26 年の各種調査 (Synergy Research ・ IDC ・ WSTS ・ Counterpoint 等) に基づく概算。市場の定義により数値は大きく変動。1 ドル = 約 160 円で換算。ネットワークは DC 向けスイッチ機器分、DC 運営は施設賃貸 (コロケーション) 分。AI 需要で DC 電力消費は 2030 年に約 2 倍の見込み (IEA) 。※ 2026 年 7 月時点。投資判断はご自身で。